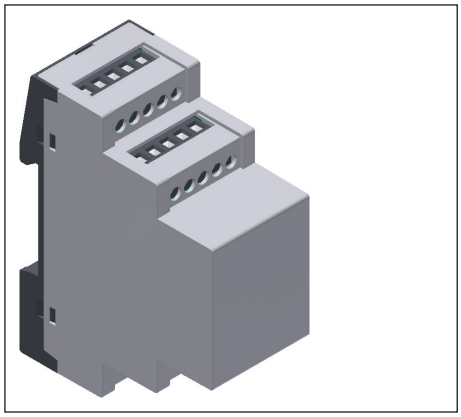
Boîtiers isolants KU 4188

selon DIN 43 880 pour tableaux de distribution profondeur utile 70 mm



Vos avantages

- Modulaire et flexible
- En maximum d'espace
- Connectique variable
- Adaptation personnalisée aux souhaits du client

Propriétés

- Largeur 35 mm
- Profondeur assignée 64 mm pour cote de profondeur max. 70 mm selon DIN 43880
- Exécutions possibles:
  - sans bornes
  - avec bornes à circuits imprimés
  - avec bornes à vis enfichables
  - avec bornes à ressorts enfichables
  - avec combinaisons de différents types de bornes
- Peuvent recevoir jusqu'à 2 circuits imprimés avec bornes et platine supplémentaire pour affichage ou organes de commande sur la face avant; en option peuvent recevoir jusqu'à 6 circuits imprimés avec bornes
- Sur demande, ouvertures pour bornes de raccordement et organes de commande KNX et RJ45
- Option plaque de fond avec cloisons latérales pour monter les modules de circuits imprimés

Caractéristiques techniques

Références de commande:	standard	UL
sans bornes:	0061102	0066501
bornes à circuits imprimés:	0060120	0066503
bornes à vis enfichables:	0060121	0066502
bornes àressorts enfichables:		0066623
bornes en caisson:	0060292	0066504

Dimensions extérieures: 35 x 90 x 71

Matériau des boîtiers
capot: PC-GF, PC (UL) gris clair RAL 7035
plaque de fond: PC-GF, PC (UL) noir d'ébène RAL 9005
bloc de bornes: PC-GF, PA66/6 (UL)
support de raccordement: PA66 (UL)

Résistance à la température		PC-GF	(UL) PC	(UL) PA 66/6	(UL) PA 66
selon UL 746 B:		115 °C	115 °C	120 °C	150 °C
selon Vicat ISO 306	méth. B:	145 °C	146 °C	230 °C	245 °C
selon ISO 75-2	(1,8 MPa):	136 °C	123 °C	225 °C	120 °C
	(0,45 MPa):	142 °C	142 °C	235 °C	231 °C

Puissance dissipée max.: 7 W pour boîtier individuel en climat normal 23/50-1 — ISO 554

Résistance thermique spécifique: R_{th} = 15 K / W

Comportement à la combustion selon UL 94: tous les matériaux de boîtier V-0 exeption: PA66 (UL); HB irradié

Nombre de bornes: chacun aver 20 bornes à vis et bornes à circuits imprimés; 16 bornes en caisson, moins sur demand

Fixation des boîtiers: par encliquetage sur rail — EN 60 715

Tenue aux lignes de fuite: — IEC 60 112
PC-GF: CTI 175 ≙ matériau isolant III a
PC: CTI 225 ≙ matériau isolant III a
PA66/6: CTI 550 ≙ matériau isolant II
PA66: CTI 600 ≙ matériau isolant I

Degré de protection: face supérieure IP 40 — IEC 60 529
plaque de fond IP 30
(ouvertures pour raccordement IP 20)

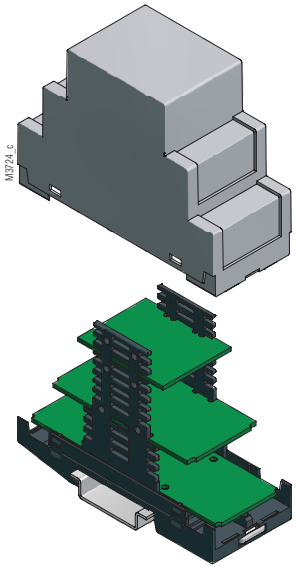
Zone d'inscription: 33,5 x 41,5 mm

Platine de C.I.: voir découpes
Supports des platines, horizontal: fixation sur la plaque de fond par vis et / ou au-dessus des cloisons latérales
Supports des platines, vertical: par nervures dans le capot

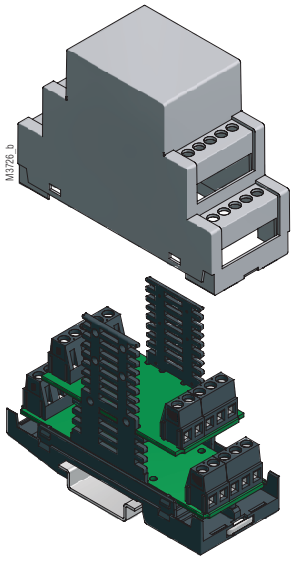
D'autres informations sur notice G02 "Présentation du terminal"

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l'édition en cours. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.

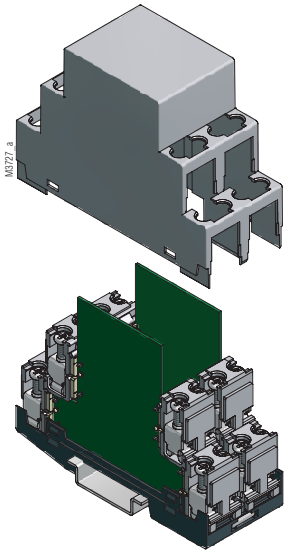
Schémas éclatés



sans bornes

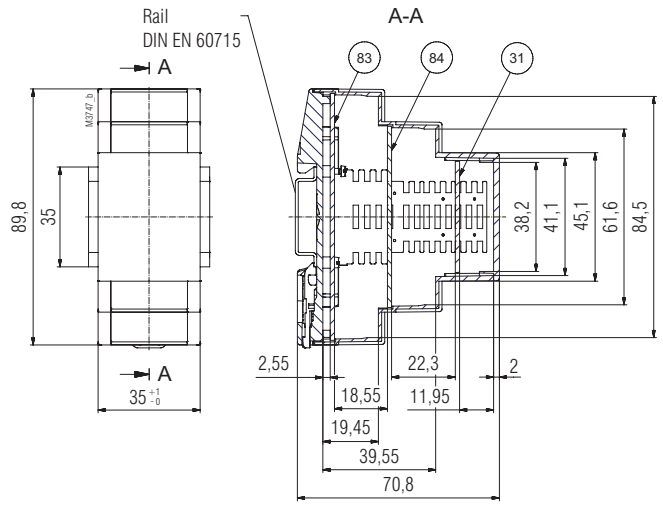


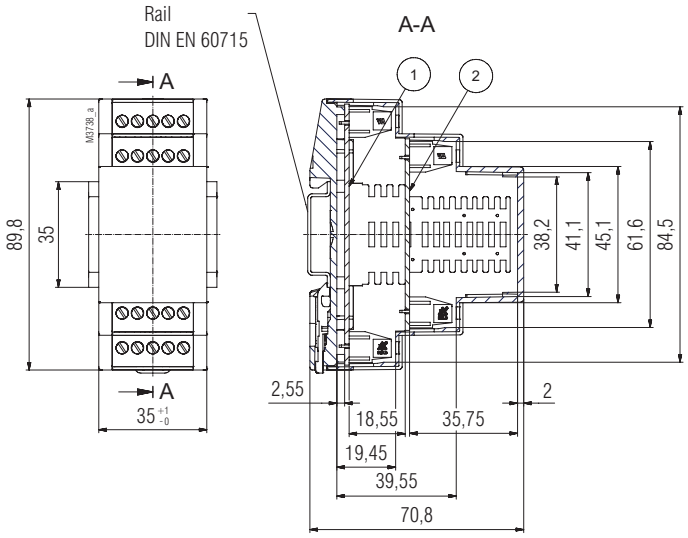
Bornes à circuits imprimés

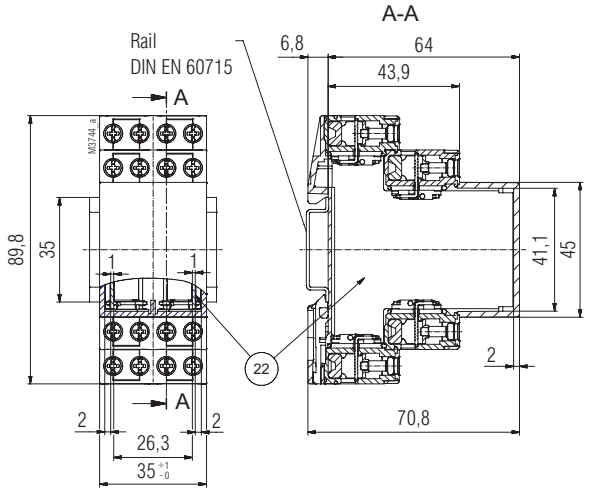


Bornes en caisson

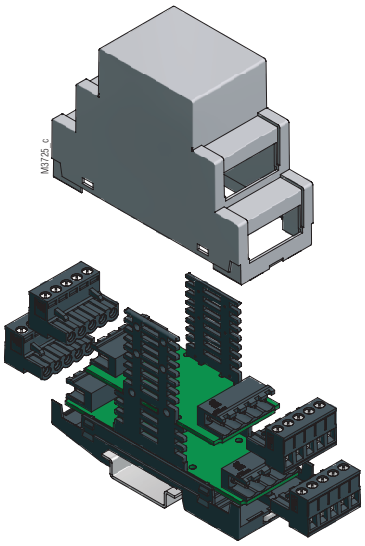
Dimensions



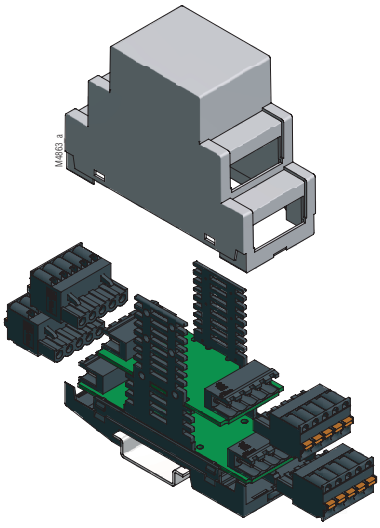




Schémas éclatés

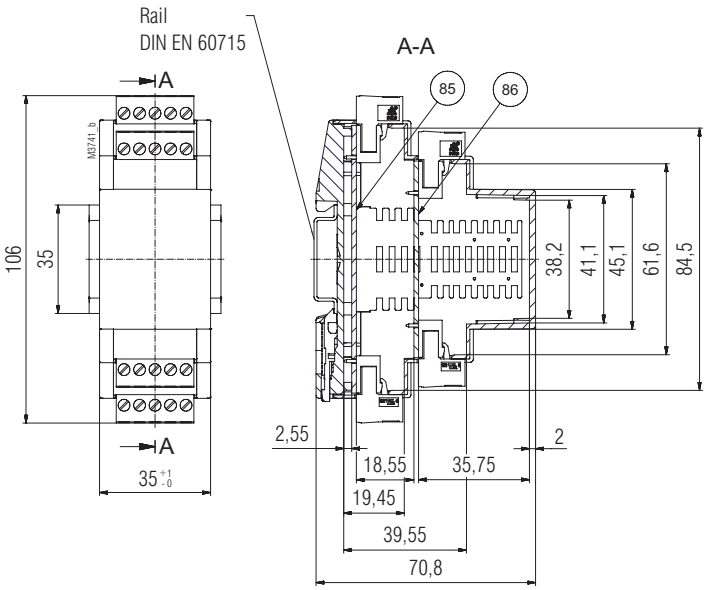


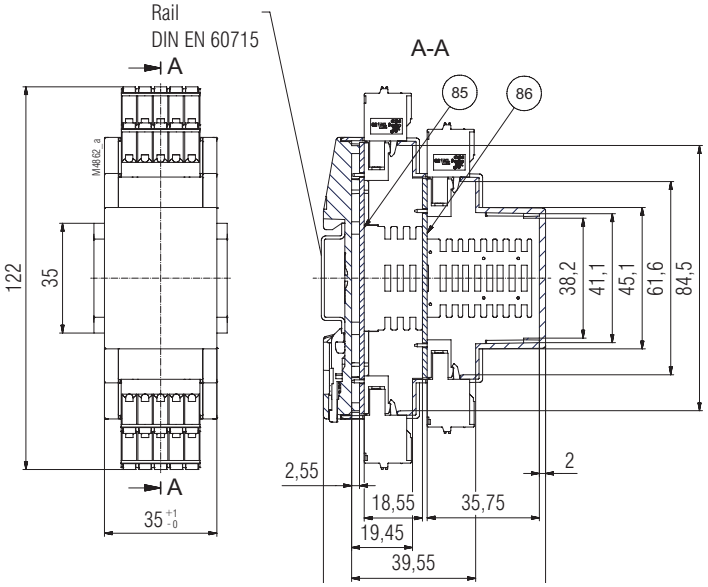
Bornes à vis enfichables



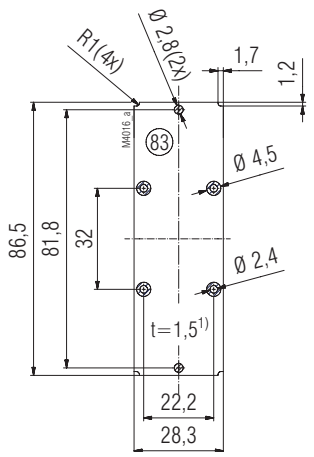
Bornes ressorts enfichables

Dimensions

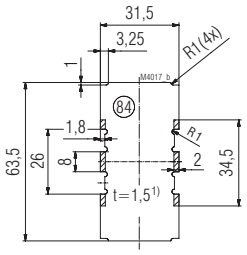




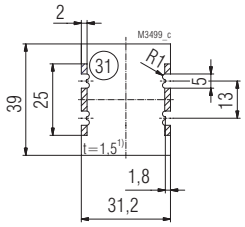
Découpes des cartes de C.I.



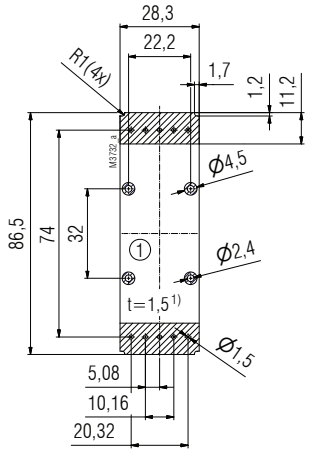
Cartes de C.I. en position-LP B*
pour boitiers fermés ou fraisés



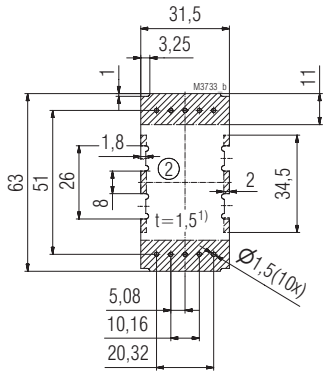
Cartes de C.I. en position-LP M*
pour boitiers fermés ou fraisés



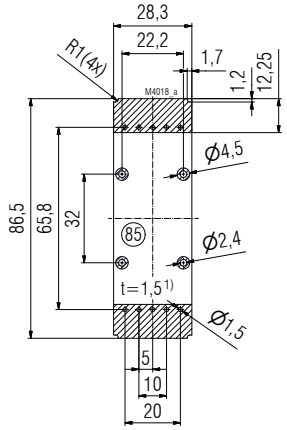
Cartes de C.I. en position-LP F*
pour boitiers fermés ou fraisés



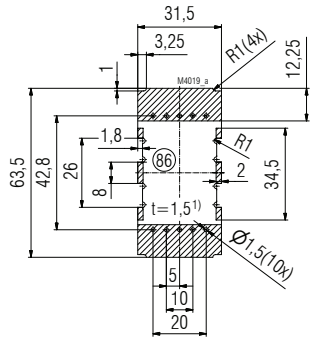
Cartes de C.I. en position-LP B*
pour bornes enfichables 2 x 5 pôles



Cartes de C.I. en position-LP M*
pour bornes à circuits imprimés 2 x 5 pôles



Cartes de C.I. en position-LP B*
pour bornes à circuits imprimés 2 x 5 pôles



Cartes de C.I. en position-LP M*
pour bornes enfichables 2 x 5 pôles

Surface interdite

1) Tolérance selon DIN EN 60 249-2-4; Tolérance générale: PERFAG 2 E

Trous ø 2,4 si nécéssaire. pour visser sur la plaque inférieure avec un vis cylindrique de ISO 1207 M2x4